

ANDUS-Partner im Außendienst

Um den Kunden eine schnelle Umsetzung ihrer Projekte zu ermöglichen, setzt die **ANDUS ELECTRONIC GMBH** auf eine kompetente Beratung "vor Ort".

Vielfältige Wirtschaftszweige sowie unterschiedliche Produkthanforderungen setzen einen eng vernetzten Know-How-Transfer unter den Unternehmen voraus. Kunden-nähe, Kompetenz, Qualität und Schnelligkeit sind die Grundlagen unseres Tuns.

Im dritten Teil unserer Partner im Außendienst stellen wir Ihnen heute die Außendienstmitarbeiter im Nordwesten Deutschlands und im skandinavischen Raum vor.



Jörg Thomas



Mogens Nicolaisen

Herr Thomas ist seit 2004 bei unserem Handelspartner, der **Schroeter KG**, tätig. Er betreut unsere Kunden in den nördlichen Teilen Niedersachsens (PLZ-Bereiche 26 bis 32), in Hamburg südlich der Elbe und in einem kleinen Teil Nordrhein-Westfalens (PLZ 32).

Sie erreichen **Herrn Thomas** im Vertriebsbüro Hamburg unter:
Telefon: 040 600006-20
Fax: 040 600006-30
E-Mail: j.thomas@andus.de

Herr Nicolaisen machte sich 1984 mit der Firma **Mintec** selbständig und betreut seitdem unsere Kunden im skandinavischen Raum.

Zu seinen Vertriebsgebieten gehören Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland.

Sie erreichen **Herrn Nicolaisen** unter:
Telefon: 0045 8641-3644
Fax: 0045 8641-3025
Mobil: 0045 40335331
E-Mail: m.nicolaisen@andus.de

Haus-Information

Zum 22. Mal findet die internationale Fachmesse



electronica
14. - 17. November 2006

in München statt.

Unser **ANDUS**-Messteam wird in der **Halle B1 Stand 205**

vertreten sein.

Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Stand zu informativen Fachgesprächen begrüßen zu dürfen und laden Sie dazu recht herzlich ein.

Bitte nehmen Sie für eine kostenlose Eintrittskarte Kontakt mit

Frau Michaela Iden
Telefon: 030 610006-41
E-Mail: m.iden@andus.de

auf.

Veränderung ist Fortschritt!

Somit freuen wir uns, Ihnen heute

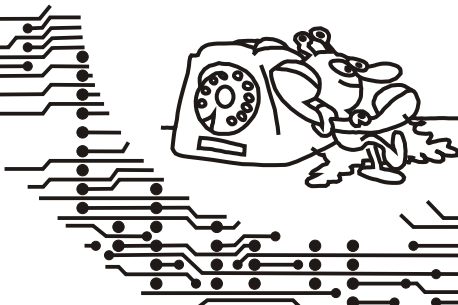


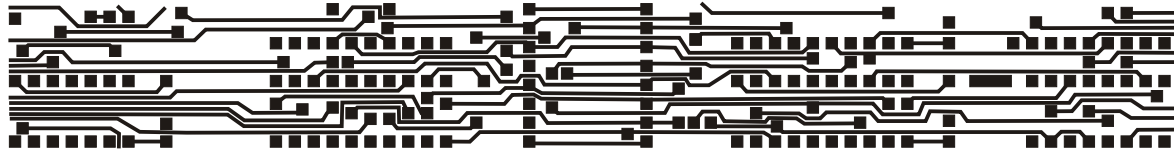
Herrn
Jürgen Zieres

vorstellen zu dürfen.

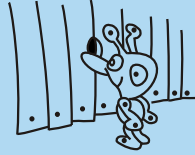
Herr Zieres ist zum Juli 2006 Mitgesellschafter der **ANDUS** geworden und mit in die Geschäftsführung eingetreten. Herr Zieres verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Elektronikindustrie, insbesondere der LCD- und Leiterplattentechnik.

Unter der Führung von Herrn Zieres wird Ihnen die **ANDUS ELECTRONIC GMBH** auch weiterhin als zuverlässiger Partner in allen Bereichen der Leiterplattentechnik zur Verfügung stehen.





Blick in die Technik:

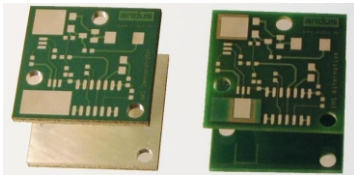


Metallkern, Heatsink & Co - Konstruktionen für Leistungsanwendungen -

Kleiner, schneller, heißer... diesem Trend folgen immer mehr Baugruppen. Die richtige Entwärmungstechnik entscheidet oft über den Erfolg eines Produkts und das nicht nur bei Laptops und Antriebssteuerungen. Die folgenden Konstruktionen geben einen Überblick über die heute meistverwendeten Technologien.

IMS: Insulated Metal Substrate

Einseitige Leiterplatte auf Aluminiumträger, getrennt durch eine hauchdünne Isolierschicht.

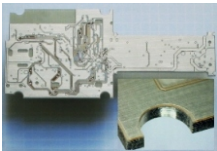


Einsatzgebiete:

IMS ist vor allem für LEDs und kleine Powerbauteile geeignet und überall dort, wo hohe Verlustwärme direkt an ein Metallsubstrat abgegeben werden muss.

Durch neue Produktionsmaschinen werden IMS und Heatsink-Leiterplatten von **ANDUS** auch mit komplexeren Konturen gratfrei und glatt gefräst. Jetzt sind sogar präzise Gewinde und Senkungen möglich.

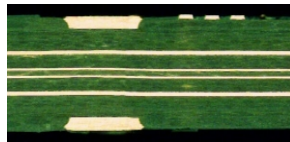
Heatsink: Leiterplatte auf Aluminiumträger



Bilayer und Multilayer werden auf Aluminium-Heatsinks laminiert, um die Verlustwärme von hohen Strömen und Leistungsbauteilen optimal zu verteilen und gleichzeitig mechanisch zu stabilisieren.

Die Anwender profitieren davon, dass gegenüber IMS auch komplexere Schaltungen möglich sind.

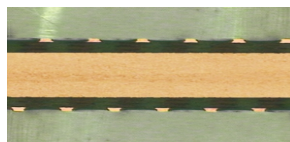
Dickkupfer und Eisberg



Der Kupferquerschnitt kann durch Verwendung von Dickkupfer (z. B. 210µm, 400µm) stark vergrößert werden. Damit sind nur noch grobe Strukturen (Schichtdicke x 3) möglich. Möchte man auf einer Dickkupfer-Lage gleichzeitig feinere Strukturen realisieren, kann man die Eisberg-Technik anwenden (siehe Bild).

Kupfer-Inlay-Technik

Massivkupfer von 0,5 bis 3 mm Dicke kann in Leiterplatten integriert werden.



Einsatzgebiete:

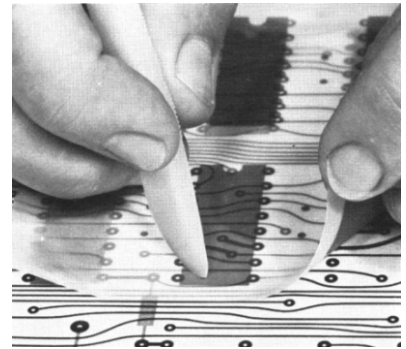
Massivkupfer kommt überall dort zur Anwendung, wo größte Querschnitte, z. B. für Ströme von mehreren 100 A, gefordert sind. Die Hochstrom-Anbindung an das Kupfer erfolgt über Schraub-, Löt- oder massive Einpresskontakte (z. B. von Fa. Amphenol). Das Kupfer kann zusätzlich mittels Tiefenfräsung freigelegt werden. Steuerleitungen zum Kupferkern werden über Sacklöcher angebunden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Details zu Design und Aufbau können wir mit Ihnen am besten anhand Ihrer konkreten Anforderung besprechen. Die entsprechenden Kontaktpartner finden Sie unter

www.andus.de

Zurückgeblickt (Folge 3)

Einseitige Leiterplatten und Bilayer mit Fotovorlagen in Klebtechnik bestimmten die Technologie der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts. In mühevoller Kleinarbeit arbeiteten ganze Teams von Mitarbeitern am Layout „komplexerer“ Schaltungen.



Bohrungen wurden mit Hilfe von Bohrschablonen registriert, welche auf die Leiterplatte gelegt wurden. An Ständerbohrmaschinen bohrten dann Mitarbeiter die von Hand geführten Platinen.

Übrigens...

... kenn' Se den schon?



Tipp zur Elektronik-Miniaturisierung:

Gewicht und Größe von Power-Schaltungen reduzieren sich vor allem an heißen Sommertagen gerne ganz von selbst.

